



En collaboration avec Soitec, STMicroelectronics annonce la disponibilité de la filière CMOS FD-SOI en 28 nm par l'intermédiaire de CMP

Les leaders en technologie microélectronique ST, Soitec et CMP aident les universités, les laboratoires de recherche et les entreprises à réaliser des prototypes de systèmes sur puce de nouvelle génération

Genève et Grenoble, le 18 octobre 2012 — STMicroelectronics (NYSE:STM), Soitec et CMP (Circuits Multi-Projets®) annoncent ce jour que la technologie CMOS totalement déplétée sur silicium sur isolant (FD-SOI) en 28 nm de STMicroelectronics, qui utilise des substrats silicium innovants développés par Soitec, est à présent mise à la disposition des universités, des laboratoires de recherche et des entreprises de conception aux fins de prototypage par le biais des services de courtage de CMP. ST met cette technologie de fabrication à la disposition des tierces parties au moment où ses premières tranches commerciales approchent de la phase de finalisation.

L'introduction de la technologie CMOS FD-SOI en 28 nm de ST dans le catalogue de CMP capitalise sur la collaboration fructueuse qui a permis à des universités et des entreprises de conception d'accéder aux générations précédentes de la technologie CMOS, parmi lesquelles celles en géométries de 45 nm (introduction en 2008), 65 nm (2006), 90 nm (2004) et 130 nm (2003). Les clients de CMP peuvent également accéder à la technologie SOI (Silicium sur Isolant) en géométries de 65 et 130 nm, ainsi qu'à la technologie SiGe (Silicium Germanium) en 130 nm de STMicroelectronics. À titre d'exemple, 170 universités et autres entreprises ont reçu les règles de dessin et les kits de conception correspondant au processus CMOS en 90 nm de ST, tandis que plus de 200 universités et entreprises ont déjà reçu les règles de dessin et les kits de conception des processus CMOS SOI et en silicium massif (bulk) en 65 nm de ST.

Depuis que CMP propose la technologie CMOS en silicium massif 28 nm de ST en 2011, environ 60 universités et sociétés de microélectronique ont reçu les règles de dessin et les kits de conception correspondants, et 16 circuits intégrés ont déjà été fabriqués.

« L'utilisation de ces processus pour concevoir des circuits intégrés a rencontré un vif intérêt. Ainsi, environ 300 projets ont été conçus en 90 nm (terminés en 2009), et déjà 300 projets utilisent déjà le processus de 65 nm », a déclaré Bernard Courtois, Directeur du CMP. « Par ailleurs, plus de 60 projets ont déjà été réalisés en technologie SOI 65 nm. Il est intéressant de souligner que nombre des plus grandes universités d'Europe, des États-Unis/Canada et d'Asie ont déjà bénéficié de la collaboration entre CMP et ST. »

Le service multi-projets sur tranches silicium du CMP permet aux entreprises de réaliser des circuits intégrés avancés en petites quantités, typiquement entre quelques douzaines et quelques milliers d'unités. Le coût de la technologie CMOS 28 nm a été fixé à 18 000 euros par mm², avec

une commande minimale de 1 mm².

« Alors que les premiers projets réalisés en technologie FD-SOI sont déjà en cours, l'heure est venue de partager cette filière avec les communautés de chercheurs. Notre technologie de fabrication FD-SOI permet de migrer rapidement et facilement les projets existants vers l'environnement FD-SOI pour qu'ils bénéficient d'importants avantages de consommation et de performances », déclare Philippe Magarshack, vice-président exécutif Design Enablement & Services de STMicroelectronics. « De plus, en permettant aux universités d'avoir accès aux technologies de pointe, nous pourrions attirer les jeunes ingénieurs parmi les plus talentueux, conformément à notre ambition de demeurer un leader technologique sur le long terme. »

« Notre partenariat avec STMicroelectronics et CMP est un nouvel exemple de l'engagement de Soitec à fournir des solutions utilisant des matériaux différenciés sur le marché libre, ainsi que de soutenir le développement continu de l'écosystème FD-SOI et les utilisateurs de technologies avancées », a déclaré Steve Longoria, vice président senior en charge du développement stratégique mondial de Soitec. « Grâce à ce partenariat, nous allons assister à l'apparition de nouveaux produits innovants basés sur les produits FD-SOI de Soitec, réalisés grâce aux moyens mis à la disposition des universités et d'autres clients pour développer et tester des circuits intégrés de nouvelle génération. »

À propos de STMicroelectronics

ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power et les applications de convergence multimédias. De la gestion de la consommation aux économies d'énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « [life.augmented](#) ».

En 2011, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,73 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com

A propos de Soitec

Soitec est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances. Ses produits, des substrats pour circuits intégrés, notamment à base de SOI (Silicium On Insulator) et des systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™, ainsi que son expertise en épitaxie, en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et d'efficacité énergétique pour une large palette d'applications destinées aux marchés de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique automobile, de l'éclairage et des centrales solaires à forte capacité. Soitec a aujourd'hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en Allemagne et aux États-Unis. www.soitec.com.

A propos de CMP

Le CMP est un courtier en circuits intégrés et en MEMS (microsystèmes électromécaniques) pour les besoins du prototypage et de la production à petits volumes. Les circuits sont fabriqués pour les universités, les laboratoires de recherche et les sociétés industrielles. Des technologies industrielles avancées sont disponibles pour les filières CMOS, BiCmos, BiCMOS SiGe, tensions élevées et FD-SOI jusqu'à 20 nm, AsGa pHEMT, MEMS, etc. CMP distribue et prend en charge plusieurs logiciels de CAO pour les sociétés industrielles et les universités. Depuis 1981, plus de 1 000 institutions réparties dans 70 pays ont été servies, plus de 6 000 projets prototypés à travers 700 essais, et 60 technologies différentes mises en interface. Pour de plus amples informations,

rendez-vous sur <http://cmp.imag.fr>.

Contacts presse

STMicroelectronics:
Pascal Boulard
Tél : 01.58.07.75.96
Mobile : 06.14.16.80.17
pascal.boulard@st.com

Soitec
Camille Darnaud-Dufour
+33 679 49 51 43
Camille.darnaud-dufour@soitec.com

CMP
Bernard Courtois
Tel: +33 4 76 57 46 15
Bernard.Courtois@imag.fr